

협피치화 대응을 위한 전해동박의 개발 현황

Development Status of Electrolytic Copper Foil for Fine Pitch PCB

전상현*

*LS엠트론 수석연구원 (E-mail : shjeon@lsmtron.com)

초 록 :

패키징용 PCB를 비롯한 대부분의 PCB는 동박을 소재로 사용하게 된다. 패키징용 PCB를 중심으로 한 PCB의 협피치화에 대응하기 위해서 전해동박의 저조도화, 박형화에 대한 필요성이 증대되고 있다.

동박의 제조공정은 드럼상에 Cu를 도금하는 공정(EM 공정), 표면에 조도를 부여하고 내열, 방청성 등을 부여하는 공정(TM공정), 절단하는 공정(SM공정)으로 이루어진다. 동박의 저조도화를 위해서는 EM 및 TM공정의 첨가제 개발 및 저조도 도금 공정 개발이 필요하다. 박형화를 위해서는 얇은 두께에서도 핸들링이 가능하도록 동박의 강도를 높이거나 제조공정을 개선하는 연구가 필요하다.

본 발표에서는 이러한 전해동박의 제조공정을 소개하고 협피치화 대응을 비롯한 전해동박의 개발 방향에 대해서 소개하고자 한다.